【抗辐照视觉与图像器件封装测试与试验项目】采购需求

**一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：**

**（一）采购标的需实现的功能或者目标**

该采购项目为抗辐照视觉与图像器件的封装测试与试验1项。该器件通过LVDS 或LVCMOS 接口接收四路相机信号，内部集成专用图像处理加速模块，轻量级深度学习网络、双C6713 DSP 内核、单Leon3 CPU，通过配置和变成后，可完成空间三维视觉计算、复杂背景检测和识别等典型任务，通过以太网、RapidIO 或其他物理端口传输运算结果。该器件适合于空间图像与信息处理应用场合，面向空间攻防、碎片主动清除、在轨自主维护等重大工程，解决在轨视觉信息处理与应用关键问题，提供核心高端处理器件，满足在轨环境的实时智能探测与感知计算应用需求。需要进行器件的封装测试与试验，以满足用户使用。

**（二）为落实政府采购政策需满足的要求**

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 软件和信息技术服务业 。

**二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：**

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

中标人应具备自有的芯片封装测试试验平台，支持器件封装、测试、可靠性试验等器件生产试验全流程。

**三、采购标的概况**

（一）采购项目名称：抗辐照视觉与图像器件封装测试与试验

（二）采购数量及计量单位：1项

（三）最高限价：297万人民币元。

（四）交付时间：合同签订后180天内。

（五）交付地点：曲江校区西四楼指定地点。

（六）付款进度安排：合同签订后预付30%，验收合格付余款。

**四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：**

1. 具备40nm工艺的陶瓷气密性封装能力，完成封装形式为CCGA的封装500只。电路面积16\*16mm2，封装合格率大于50%，质量等级：YB级（去除密封性相关的试验项目）；
2. 需要进行450支电路产品的筛选，包括稳定性烘焙、PIND、离心试验、动态和静态老化试验、密封性检查、外部目检。筛选合格率大于85%，老化PDA小于3%
3. 具备ATE机台测试能力，机台指标覆盖详规要求，按详规指标要求进行器件三温测试时间大于400h。

,**五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求**

1. 质保期： ≥3年。质保期满后，仍需提供专业技术支持，投标人在投标文件中需注明技术支持单项报价。
2. 服务响应时间：接到需求电话后4小时内给予技术支持反馈。保期外，半年内免费提供技术支持服务，包括技术服务人员的路费、食宿、通讯费。

**六、采购标的的履约验收标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场的检验指标及方法 | | | |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 | |
| **项目建设单位验收要求：** | | | |
| 1 | 视觉与图像处理器件封装服务 | 产品的批次合格率大于50%；筛选合格率大于85%；老化PDA小于3%；工艺、材料基线能力范围文件；工艺流程图及版本号；基线所有生产过程的PID文件；产品结构分析合格报告、基线工艺/材料鉴定试验合格报告和极限试验报告。 | |
| 2 | 视觉与图像处理器件测试服务 | 数量符合课题要求；附测试向量、测试报告。 | |
| 3 | 视觉与图像处理器件试验服务 | 数量和总时长符合课题要求；附可靠性试验报告、鉴定试验报告等 | |
| 验收时是否需要供应商提供样品 | | 是■ | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 | | 是□ | 否■ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 | | | |
| 除现场验收外，是□否□需提供第三方检测报告 | | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。  对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 | |